

PAP

JESINE
洁芯半导体
JESINE SEMICONDUCTOR

Plasma Assisted Polishing

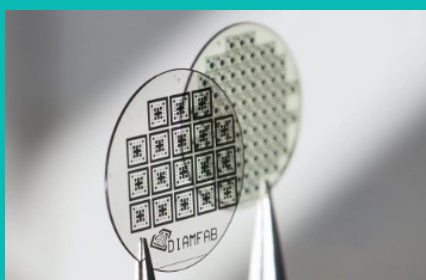
等离子辅助干式抛光机 PAP



难削材高精度抛光

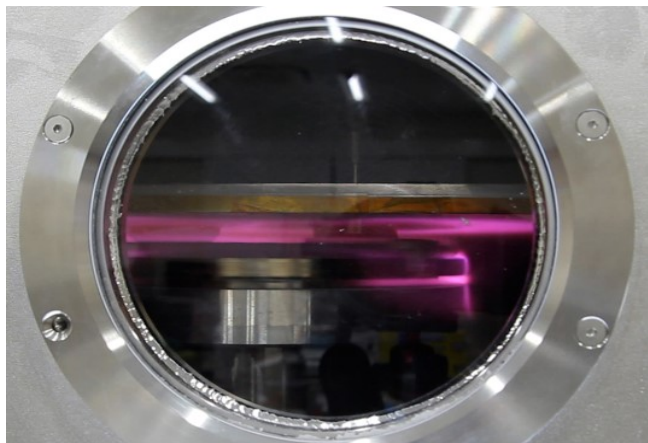
无产生加工变质层

金刚石表面平坦化设备

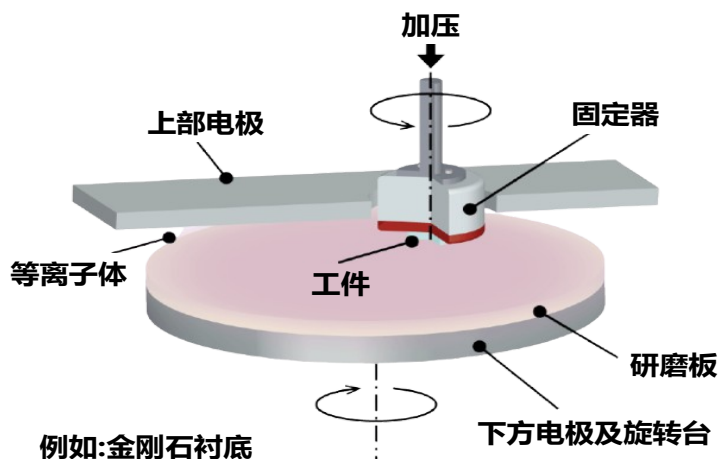


**第四代半导体
Diamond**

加工平台

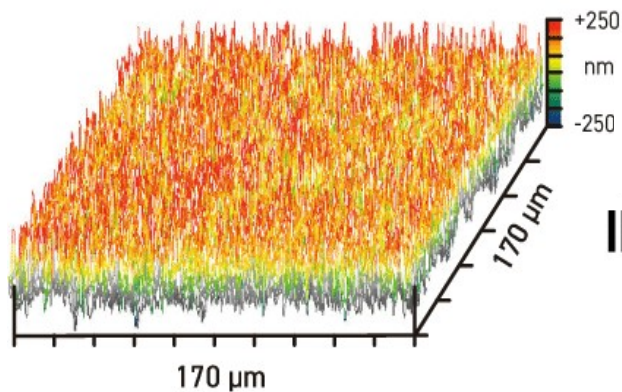


加工原理



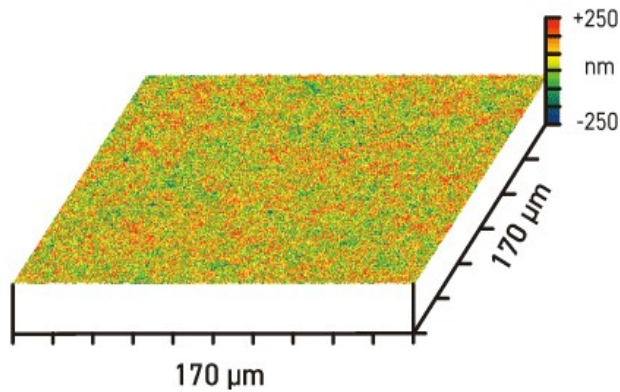
加工案例

加工前



加工前表面粗糙度
Sa; 61.8nm

加工后



加工后表面粗糙度
Sa; 0.31nm

加工时间

3个
小时